



平成 25 年 4 月 5 日

各 位

会 社 名 株式会社アムスク
代表者名 代表取締役社長 栗原 新太郎
(コード 7468)
問合せ先 常務取締役管理本部長 平井和明
(TEL 03-5302-1569)

「半導体販売事業に関するお知らせ
(会社分割(吸収分割)による吸収分割承継会社への事業承継及び当該吸収分割承継会社
株式の一部譲渡(子会社の異動)について)」の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 2 月 1 日に開示いたしました「半導体販売事業に関するお知らせ(会社分割(吸収分割)による吸収分割承継会社への事業承継及び当該吸収分割承継会社株式の一部譲渡(子会社の異動)について)」において、当社と株式会社シリアル・アムスク・マイクロエレクトロニクス(以下「承継会社」といいます。)との会社分割(以下「本会社分割」といいます。)について、記載内容の一部について変更すべき事項がありましたので、下記のとおり変更いたします(変更箇所には下線を付しております。)。なお、下記の変更理由のとおり、当社は、株主総会において、本会社分割契約の承認に係る議案を付議する必要がなくなりました。

記

【変更箇所】

2. 当該会社分割の要旨

(1) 当該会社分割の日程

(変更前)

本会社分割取締役会決議日	平成 25 年 2 月 1 日
本会社分割契約締結日	平成 25 年 <u>3</u> 月 (予定)
株主総会基準日公告日	平成 25 年 3 月 26 日 (予定)
株主総会基準日	平成 25 年 4 月 10 日 (予定)
株主総会開催日	平成 25 年 5 月 8 日 (予定)
効力発生日	平成 25 年 5 月 15 日 (予定)
金銭交付日	平成 25 年 5 月 15 日 (予定)

(変更後)

本会社分割取締役会決議日	平成 25 年 2 月 1 日
本会社分割契約締結日	平成 25 年 <u>4</u> 月 (予定)
効力発生日	平成 25 年 5 月 15 日 (予定)
金銭交付日	平成 25 年 5 月 15 日 (予定)

※分割会社である当社においては、会社法第 784 条第 3 項に規定する簡易分割に該当し、承継会社においては、会社法第 796 条第 1 項に規定する略式分割に該当するため、当社及び承継会社において吸収分割契約承認株主総会を開催いたしません。

【変更理由】

本会社分割により承継会社に承継する資産・負債を検証した結果、分割会社である当社において簡易分割（会社法第 784 条第 3 項）の要件を満たすことが判明したことから、会社法に基づき手続きの変更を行うものです。

以 上